

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于深圳佰维存储科技股份有限公司**  
**2025 年度持续督导跟踪报告**

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司名称：深圳佰维存储科技股份有限公司
保荐代表人姓名：王天琦	联系电话：0755-81902000
保荐代表人姓名：刘小东	联系电话：0755-81902000

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对佰维存储进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

**一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况**

无。

**二、重大风险事项**

本持续督导期间，公司面临的风险因素主要如下：

**（一）核心竞争力风险**

**1、研发失败的风险**

半导体存储行业技术处于不断迭代更新之中，半导体存储器设计制造企业需要持续进行产品升级和新产品开发等技术研发活动，以应对不断变化的下游市场需求和行业技术的发展。公司结合技术发展和市场需求确定研发方向，持续进行研发投入。如果未来公司在产品和技术研发方向上与市场发展趋势出现偏差，或公司在研发过程中关键技术、核心性能指标未达预期，未能持续或有效革新技术，或在将设计迁移至可行的解决方案时遇到困难，或遇到验证、认证或资格审查延

误，或面临实现大规模生产的挑战，公司将面临研发失败的风险，相应的研发投入难以收回且未来业绩也将受到不利影响。

## **2、核心技术外泄或失密风险**

公司积累和储备了一系列具有自主知识产权的核心技术，拥有覆盖研发及生产过程中的各个关键环节的数百项专利。此外，公司还在进行多项面向主营业务的核心技术研发工作。

公司与核心技术人员签订了保密协议和竞业禁止协议，对其在保密义务、知识产权及离职后的竞业情况作出严格规定，以保护公司的合法权益，防止核心技术外泄。未来，公司若发生核心技术外泄或失密，可能对公司生产经营的可持续性造成一定不利影响。

## **3、技术人员流失风险**

公司自成立起深耕半导体存储器行业，经过多年的不断积累，形成了较为完善的研发体系和专业的人才队伍。公司在存储介质特性研究、固件研发设计、硬件开发、封装设计与技术研发、芯片测试等领域拥有深厚的技术积累。

公司高度重视人才队伍建设，并采取股权激励等措施吸引优秀技术人员，以保持人才队伍的稳定，但未来不排除因行业内竞争对手提供更优厚的薪酬、福利待遇或其他因素导致公司技术人才流失，对公司持续竞争力和业务发展造成不利影响。

## **(二) 经营风险**

### **1、宏观经济环境变动风险**

随着宏观经济形势的变化，半导体存储器的上游原材料供应及下游应用领域的市场景气度可能存在一定不稳定性，特别是在国际贸易形势变化、中美贸易摩擦的背景下，逆全球化势头抬升，全球经济发展面临新的不确定性。原材料采购端，公司核心原材料存储晶圆主要采购自国内外存储晶圆原厂。如果未来国际贸易形势恶化、中美贸易摩擦加剧，可能会影响公司晶圆供应并对经营业绩带来不利影响。销售端，公司主要产品为智能移动及 AI 新兴端侧存储、PC 及企业级存储、智能汽车及其它应用存储，应用领域覆盖移动智能终端、PC、行业终端、数

据中心、智能汽车、移动存储等多个领域，客户范围通过中国香港地区物流、贸易平台辐射全球。如果未来全球宏观经济环境恶化，下游存储客户需求或出现下降，进而对公司的经营业绩带来不利影响。

## **2、原材料价格波动风险**

公司主要原材料为 NAND Flash 及 DRAM 晶圆，存储晶圆的采购价格变动对公司的成本结构具有较大影响。同时，存储晶圆的制造要求极高，投资巨大，全球厂商较少，扩产周期长，导致了晶圆的生产产能相对刚性，而存储晶圆的下游市场，电子产品需求变动较快，AI 相关应用的下游需求则可能迅速变化。因此，存储晶圆市场容易出现暂时短缺或供应过剩的情况，导致价格频繁波动。若存储晶圆价格大幅波动，公司产品的价格及利润率或会出现显著波动。此外，预期晶圆价格上涨可能会促使下游客户短期囤货，而预期价格下跌则可能导致采购延迟，这两种情况均可能加剧供需失衡，并引发价格进一步波动，从而对公司盈利能力造成不利影响。

存储晶圆价格在 2025 年第一季度触底后，伴随着上游厂商库存压力释放，叠加 AI 算力、物联网、智能汽车、工业机器人等下游应用领域的不断拓展，技术持续更新迭代，相关存储晶圆的价格进入上行通道，2025 年 3 月起部分存储晶圆价格企稳回升。若未来存储晶圆价格大幅波动，将导致存储产品的利润率出现大幅波动，甚至可能需对公司存货等资产计提大额跌价准备，从而大幅减少公司盈利，在极端情况下将有可能导致公司营业利润出现下滑，甚至出现亏损。

## **3、供应商集中度较高的风险**

公司主要原材料 NAND Flash 晶圆和 DRAM 晶圆产能在全球范围内集中于国际存储晶圆原厂，其经营规模及市场影响力较大。公司与全球主要存储晶圆制造厂及其经销商建立了稳定的采购关系。未来，若公司主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限、与公司合作关系发生变化或国际贸易形势恶化，可能导致公司无法按时按需采购相关原材料，从而对公司生产经营产生不利影响。

## **4、国际贸易争端加剧及半导体设备进口受限的风险**

公司晶圆级先进封测制造项目的拟建设的封装生产线涉及晶圆加工相关的

倒装、光刻、薄膜、湿法等工艺流程，需要采购相应的半导体设备，主要设备供应商为美国、日本等外资厂商且已经与公司签署供货合同，设备交付按计划执行中，相关设备目前均不涉及国际间有关出口管制的规则。公司始终坚持合规运营，依法开展生产经营活动，如果未来国际贸易争端进一步加剧，不排除美国、日本等国家进一步收紧向中国大陆出口半导体设备的限制，则可能会影响该项目的实施进度和预期效益，从而对公司整体生产经营状况和业务发展带来不利影响。

## 5、客户集中度较高的风险

2023年至2025年，公司前五大客户的营业收入占公司营业收入的比例分别为32.3%、46.7%和40.95%，客户集中度相对较高。目前公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果未来公司与下游主要客户的合作关系出现重大不利变化，或现有主要客户因宏观经济变动、市场竞争加剧或者自身业务等因素影响导致主要客户对公司产品的需求大幅度减少，且公司未能及时拓展新客户，将对公司的经营业绩产生不利影响。

## 6、控制权不稳定风险

截至2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人孙成思直接持有公司82,307,800股，占公司报告期末总股本的17.6888%。公司实际控制人与公司股东徐健峰（持股比例为1.2985%）、孙静（持股比例为1.0746%）、孙亮（持股比例为0.8596%）及员工持股平台深圳佰泰（持股比例为1.7193%）、深圳方泰来（持股比例为1.1175%）、深圳泰德盛（持股比例为0.6018%）、深圳佰盛（持股比例为0.4298%）于2022年6月签署的《一致行动协议》已于2025年12月30日到期，该一致行动关系自然终止，一致行动关系终止后，各方所持有的公司股份不再合并计算，各自作为公司股东，将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东权利，履行相关股东义务，在孙成思为公司实际控制人期间各方后续亦不会谋求公司的实际控制或共同控制地位。具体内容详见公司2026年1月1日披露在上海证券交易所官网的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨权益变动的提示性公告》。

另外，公司股东孙日欣（持股比例为0.0114%）为公司董事长、实际控制人孙成思的父亲，根据《上市公司收购管理办法》之规定，孙日欣为孙成思法定一

致行动人。据此，孙成思通过直接持股及一致行动关系合计控制公司 17.7002% 股份的表决权，孙成思为公司的控股股东、实际控制人。公司实际控制人控制股权比例较低，存在公司控制权不稳定的风险，可能会对公司经营管理的稳定产生不利影响。

### **（三）财务风险**

#### **1、存储器产品价格波动导致毛利率与业绩波动的风险**

存储器产品价格随市场供需状况而波动，导致公司毛利率波动，进而影响公司的盈利能力。2022 年至 2025 年，公司综合毛利率分别为 13.7%、1.7%、18.2% 和 21.4%，呈现波动性。上游晶圆供给、技术迭代、市场竞争格局，以及下游市场需求变化、监管政策变动等因素都是存储器产品价格波动的重要因素。2022 年度至 2025 年，公司营业收入 298,569.27 万元、359,075.22 万元、669,518.51 万元和 1,130,248.00 万元，归母净利润分别为 7,121.87 万元、-62,435.89 万元、16,123.34 万元和 85,303.52 万元，业绩呈现一定波动性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、存储器市场供需状况大幅波动、市场竞争日趋激烈导致存储器产品价格大幅下降等情形，公司可能会出现业绩大幅波动和盈利能力下降的情况。

公司产品主要应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。若未来公司产品所属下游行业需求下滑，且公司未能及时通过技术研发、产品竞争力抢占市场份额和持续拓展下游行业，将会导致公司产品售价下降、销售量降低等不利情形，未来经营业绩存在下滑的风险。

#### **2、存货金额较大及发生存货跌价的风险**

2022 年至 2025 年，公司存货账面价值分别为 195,408.76 万元、355,221.93 万元、353,735.13 万元和 786,841.69 万元，占公司资产总额的比例分别为 44.30%、56.10%、44.43%和 50.70%。公司存货主要由原材料和库存商品构成，各期末规模较大且占期末资产总额比例较高，主要系公司采取不同的备货策略、下游客户结构及需求变化所致。存货规模较大一定程度上占用了公司流动资金，可能导致一定的经营风险。若未来存储器行业市场发生剧烈变化，存储晶圆市场行情出现大幅下行情况，不排除公司将进一步计提存货跌价准备从而影响整体业绩的可能性。

### 3、经营活动产生的现金流量净额为负的风险

2022年至2025年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-69,259.12万元、-196,643.54万元、53,179.76万元和-196,546.48万元。公司产生正运营现金流的能力取决于多项因素，包括采购 NAND 及 DRAM 晶圆、收入增长、定价及产品组合、毛利率、运营效率、运营资金管理，以及客户付款和供应商结算的时间等。2022年至2025年，公司经营活动产生的现金流量净额存在为负情况，主要原因为公司处于快速发展阶段，对存储晶圆等关键原材料实施战略采购策略，报告期内采购原材料现金支出金额较高。未来随着业务规模的进一步扩大，若公司未能相应提高备货效率、提升存货周转速度，可能继续出现经营活动产生的现金流量净额为负的情况，从而对生产经营造成一定不利影响。如果未来公司经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，公司营运资金将面临一定压力，对公司未来业绩和持续经营造成不利影响。

### 4、偿债能力风险

2022年至2025年，公司流动比率分别为2.20倍、1.25倍、1.24倍和1.64倍，速动比率分别为0.98倍、0.34倍、0.47倍和0.50倍，合并口径资产负债率分别为45.10%、69.66%、69.47%和64.47%。公司所处存储行业具有资金密集型特征，业务经营对资金的需求量较大，同时报告期内公司业务发展快速，资金需求量较大，资产负债率相对较高。如果未来外部宏观政策以及经营环境出现重大不利影响，或公司的财务状况及经营业绩波动而无法及时偿付相关债务，可能导致公司出现重大偿债风险，对可持续经营能力造成不利影响。

## （四）行业风险

### 1、原材料价格波动大

半导体存储器产品的原材料价格波动较大，主要是市场供需的变化导致。存储晶圆的制造要求极高，投资巨大，全球厂商较少，扩产周期长，导致了晶圆的生产产能相对刚性；而存储晶圆的下游市场，电子产品需求变动较快，AI相关应用的下游需求可能迅速变化。因此，存储器晶圆市场容易出现暂时短缺或供应过剩的情况，导致存储晶圆价格频繁波动，行业内相关企业的成本会随之变动，进而带来一定的不利因素。

## 2、全行业技术更迭快

存储产品行业竞争激烈，技术发展迅速，产品的生命周期较短，因此一方面需要行业内企业能够准确地把握市场的最新发展动态，争取先入市场；另一方面在技术产品更新的过程中需要有较强的研发实力。如果行业内企业未能迎合不断变化的市场趋势、行业惯例及迅速的技术变革，产品开发周期过长，可能会导致市场份额的丢失，削弱竞争力，甚至因跟不上新技术的更迭而被淘汰，带来一定的发展风险。

## 3、国内技术人才紧缺

半导体存储器行业是典型的人才、技术及资金密集型行业，管理层的行业知识水平与核心技术人员的专业技术能力很大程度上决定了企业的竞争力，研发团队的建设以及技术水平对企业的发展来说都十分重要。但是存储器行业在我国起步较晚，人才相对紧缺。面对半导体存储器行业的快速发展，如果人才队伍紧缺，导致行业内人才成本高企，将增加企业运营成本和经营风险。

### （五）宏观环境风险

#### 1、知识产权保护相关的风险

公司自成立以来，高度重视自主知识产权的保护，在研发过程中及时申请专利保护。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共取得 521 项境内外专利和 66 项软件著作权，其中专利包括 217 项发明专利、210 项实用新型专利、94 项外观设计专利。未来如果公司未能有效保护自身产品知识产权，可能会削弱自身在市场竞争中的优势，从而影响公司的经营业绩。未来，随着公司市场地位和行业关注度进一步提升，不排除发生知识产权方面法律纠纷的风险。

#### 2、租赁物业的风险

公司主要办公场所位于深圳市南山区众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 1-4 楼及 8 栋 1-3 楼的租赁房屋已列入《2017 年深圳市南山区城市更新单元计划第四批计划》。尽管公司已取得由深圳市南山区工业和信息化局出具的复函及产权单位与出租方出具的证明，证明公司的租赁房屋预计在 2027 年第三季度之前不会启动拆迁，但不排除后续因建设周期变更而导致租赁房屋提前被拆除。

### 3、国际政治经济环境风险

近年来，国际政治经济环境变化，国际贸易摩擦不断升级，半导体产业成为受到影响最为明显的领域之一，也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。国际政治环境的不确定性可能会对半导体行业产生负面影响，包括降低晶圆制造、封测企业对半导体专用设备的需求。如果所在国贸易政策、关税、附加税、出口限制或其他贸易壁垒进一步恶化，将可能对公司客户的生产或销售能力造成不利影响，使公司客户的经营状况恶化，导致客户对公司存储产品的需求降低。此外，如果中国政府对公司从美国采购的原材料或零部件加征关税，公司的经营成本也将增加，进而会对公司的营业收入、经营成果或财务状况产生不利影响。

### 三、重大违规事项

本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

### 四、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要财务数据及变动情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,130,248.00	669,518.51	68.82
利润总额	93,177.24	16,477.88	465.47
归属于上市公司股东的净利润	85,303.52	16,123.34	429.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,514.36	6,697.72	1,072.25
经营活动产生的现金流量净额	-196,546.48	53,179.76	-469.59
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	544,024.29	241,186.90	125.56
总资产	1,552,053.92	796,095.61	94.96

2025 年度，公司主要财务指标及变动情况如下：

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.87	0.37	405.41
稀释每股收益 (元 / 股)	1.81	0.37	389.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.72	0.16	975.00
加权平均净资产收益率 (%)	19.78	7.37	增加 12.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.21	3.06	增加 15.15 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.60	6.68	减少 1.08 个百分点

1、报告期内，公司营业收入大幅度增长，共实现营业收入 1,130,248.00 万元，同比增长 68.82%；主要原因系存储行业显著复苏，产品价格上涨，总需求增加，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展全球头部客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升；

2、报告期内，公司利润总额、归母净利润、扣非后归母净利润、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增幅较大，主要原因系：

(1) 公司在智能穿戴领域深耕多年，构建了差异化的竞争优势，公司 ePOP 等代表性存储产品具有低功耗、快响应、轻薄小巧等优势，产品表现出色，目前已被国内外知名企业应用于其 AI/AR 眼镜、智能手表等智能穿戴设备上。2026 年随着 AI 眼镜的放量，公司与 Meta 等重点客户的合作不断深入，将推动公司智能穿戴存储业务的持续增长；

(2) 公司在解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域持续加大研发投入，2025 年度研发费用 63,238.08 万元，同比增长 41.34%；

(3) 公司 2025 年度股份支付费用为 25,390.52 万元，剔除股份支付费用后，2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 110,694.04 万元，与上年同期相比，将增加 60,765.26 万元，同比增长 121.70%；

(4) 报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额为 6,743.74 万元，主要为计入当期损益的公允价值变动损益以及政府补助的影响。

3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期增幅

较大，主要系公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账、经营利润持续改善以及公司紧跟行业发展趋势，积极扩建产能使得固定资产和在建工程增加。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度的减少，主要系经营性采购支出增加所致。

### 五、核心竞争力的变化情况

根据公司 2025 年年度报告，公司核心竞争力概括如下：

核心竞争力	具体情况
研发封测一体化模式	1.构建了研发封测一体化经营模式，将存储解决方案研发与先进封测深度整合，提供面向 AI 时代的半导体存储解决方案；2.主控芯片具备先进架构，适配多场景；3.掌握契合 AI 时代更高技术要求的先进封装技术，为全球唯一具备晶圆级封测技术的独立存储解决方案供应商（根据弗若斯特沙利文的资料）；4.形成技术、客户、价值三大协同优势，缩短产品周期、形成业务闭环、提升服务价值量
一体化生产与供应链	1.公司构建了封装、测试、模组组装完整生产体系，实现全流程把控；2.建设了晶圆级封测生产基地，与研发协同加速产品迭代；3.美洲、印度布局本地化生产交付，更好地满足区域客户需求
全球领先客户与高性能产品组合	1.产品覆盖智能终端、AI 端侧、汽车、企业级等主流领域；2.服务全球头部客户；3.构建性能卓越的产品组合，并率先推出了创新性存储方案
全球化业务布局	1.美洲、印度、欧洲建本地化团队，覆盖 60+ 国家、服务 500+ 海外客户；2.与全球 NAND/DRAM 供应商、晶圆代工厂深度合作，保障关键材料供应；3.获 CPU、SoC 等平台认证，进入多家全球头部品牌供应商名录
团队与研发实力	拥有专业的管理团队和经验丰富的工程师队伍，核心研发人员在半导体研发、生产制造与芯片设计方面的平均从业年限超过 10 年

综上所述，公司在以上五个方面具备核心竞争力，2025 年度公司核心竞争力未发生不利变化。

### 六、研发支出变化及研发进展

2025 年度，公司研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	63,238.08	44,743.21	41.34
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	63,238.08	44,743.21	41.34
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.60	6.68	减少 1.08 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

公司在解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域持续加大研发投入，2025 年度研发费用 63,238.08 万元，同比增长 41.34%。截至报告期末，公司研发人员数量达到 1,262 人，较上年同期增加 364 人，公司研发人员数量占公司员工总数量的 44.25%。

公司在研项目均进展正常，目前应用前景良好。

## 七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

## 八、募集资金的使用情况及是否合规

### （一）募集资金基本情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,303.2914 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，共计募集资金 60,203.05 万元，坐扣承销和保荐费用 4,997.26 万元后的募集资金为 55,205.79 万元，已由中信证券于 2022 年 12 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,939.77 万元，公司本次募集资金净额为 52,266.02 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115 号）。

#### 2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳佰

维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1,899,999,971.52元，扣除不含税发行费用人民币29,314,551.81元，实际募集资金净额为人民币1,870,685,419.71元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16号《验资报告》。

## （二）募集资金使用及结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行人民币普通股（A股）股票
募集资金到账时间	2022年12月27日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	60,203.05
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	7,937.03
二、募集资金净额	52,266.02
减：	
以前年度已使用金额	49,891.64
本年度使用金额	733.3
永久补流	1,701.60
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明（专户销户转出）	45.71
加：	

募集资金利息收入	106.23
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	0

注1：截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金金额为50,624.94万元，拟将节余募集资金1,701.33万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为1,701.60万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息所致）。截止2025年12月31日，首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。

注2：上述募集资金利息收入为截至报告期末累计利息收入。

## 2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 4 月 2 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	190,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	2,931.46
二、募集资金净额	187,068.54
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	168,233.34
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-

其他-具体说明(专户销户转出)	26.29
加:	
募集资金利息收入	34.61
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	18,843.52

### (三) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与原保荐人中信证券与杭州银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。同时,公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公司(现已更名为“广东泰来封测科技有限公司”)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并同公司、原保荐人中信证券于2022年12月5日分别与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》。根据公司2023年度向特定对象发行A股股票的需要并经公司股东大会授权,公司聘请了华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)担任本次发行的保荐人。公司及子公司与原保荐人中信证券以及存放募集资金的监管银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止,中信证券未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。

鉴于公司保荐人已发生更换,2024年7月18日,公司与保荐人华泰联合证券、存放募集资金的监管银行杭州银行股份有限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

因首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项,截止2025年12月31日,首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求,公司对本次发行的募集资金采取专户存储,设立了相关募集资金专项账户。公司与招商银行股份有限公司深圳北站支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司广东泰来封测科技有限公司(以下简称“泰来科技”)、控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司(以下简称“芯成汉奇”)与华泰联合证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“本协议”)。本协议对公司/子公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。本协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

为优化和改善募集资金使用时的审批程序,提高工作效率和募集资金使用效率,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定,公司与泰来科技、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、保荐人签订《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司2025年6月26日披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议之补充协议的公告》。

#### **(四) 募集资金实际使用情况**

##### **1、募投项目先期投入及置换情况**

报告期内,公司首次公开发行股票募集资金不存在置换募投项目先期投入的情况。

2025年5月13日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置

换预先已投入募集资金投资项目费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币160,204.18万元。具体内容详见公司于2025年5月15日刊登在上海证券交易所的《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定并已置换完毕。

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 2 日			
募集资金投资项目	总投资额	截至 2025 年 4 月 30 日自筹资金已预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目	88,947.41	65,603.65	61,541.17	2025 年 5 月 30 日	2025 年 5 月 13 日
晶圆级先进封测制造项目	129,246.09	111,168.60	98,400.00	2025 年 5 月 30 日	2025 年 5 月 13 日

注：“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”使用募集资金投资额（调整后）为 85,068.54 万元，“晶圆级先进封测制造项目”使用募集资金投资额（调整后）为 102,000.00 万元。

截至 2025 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 263.01 万元，拟使用募集资金人民币 263.01 万元置换预先支付的发行费用，置换完成时间是 2025 年 5 月 28 日，具体情况如下：

金额单位:人民币万元

项 目	发行费用总额 (不含税)	以自筹资金预先支付 发行费用金额 (不含税)	置换金额

承销及保荐费用	2,549.00	170.00	170.00
审计及验资费用	140.00	10.00	10.00
律师费用	166.98	73.58	73.58
信息披露费用	63.21	-	-
发行手续费及其他费用	12.27	9.43	9.43
合计	2,931.46	263.01	263.01

注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

## 2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年5月13日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年5月15日刊登在上海证券交易所的《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的公告》。

报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

## 4、节余募集资金使用情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“先进存储器研发中心项目”予以结项，并将节余募集资金1,701.33万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。本次节余募集资金永久补充流动资金的实际金额为1,701.60万元（实际从募集资金专户转出的金额与议案审议金额之间的差额为结息

所致)。

## 5、募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所的《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

为优化和改善募集资金使用时的审批程序，提高工作效率和募集资金使用效率，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司与泰来科技、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、保荐人签订《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司 2025 年 6 月 26 日披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议之补充协议的公告》。

公司于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司广东泰来封测科技有限公司、广东芯成汉奇半导体技术有限公司分别提供借款 85,068.54 万元、102,000.00 万元以分别实施向特定对象发行股票的募投项目“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”和“晶圆级先进封测制造项目”。具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

报告期内，公司不存在 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况。

## 6、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

本持续督导期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募

集资金使用及披露的违规情形。

### 九、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员直接持有的公司股份不存在质押、冻结的情况，前述人员直接持股情况如下：

姓名	职务	性别	年初持股数（股）	年末持股数（股）	年度内股份增减变动量（股）	增减变动原因
孙成思	董事长	男	81,136,000	82,307,800	1,171,800	股权激励归属
何瀚	董事	男	179,000	134,500	-44,500	二级市场减持
	总经理					
徐骞	董事	男	22,500	16,875	-5,625	二级市场减持
	副总经理					
王灿	董事	男	67,500	50,625	-16,875	二级市场减持
	副总经理、核心技术人员					
刘阳	职工董事	男	22,500	16,875	-5,625	二级市场减持
	副总经理					
刘世刚	董事	男	0	0	0	-
谭立峰	独立董事	男	0	0	0	-
孙广宇	独立董事	男	0	0	0	-
戚瑾	独立董事	女	0	0	0	-
黄炎烽	董事会秘书	男	31,500	23,625	-7,875	二级市场减持
	财务负责人					
蔡栋	副总经理	男	13,500	10,125	-3,375	二级市场减持
张帅	董事（离任）	男	0	0	0	-
方吉槟	独立董事（离任）	男	0	0	0	-
赵昆峰	董事（离任）	男	0	0	0	-

姓名	职务	性别	年初持股数（股）	年末持股数（股）	年度内股份增减变动量（股）	增减变动原因
王源	董事（离任）	男	0	0	0	-
合计	/	/	81,472,500	82,560,425	1,087,925	/

注：1. 上述持股数为直接股数。

2. 以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

#### 十、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人： 王天琦

王天琦

刘小东

刘小东

华泰联合证券有限责任公司

